

技術資料

FeedBond® EP-30-UF1B

封裝絕緣膠

簡介:

FeedBond®EP-30-UF1B 為單組分熱固化粘合劑，專為 CSP/BGA/SMT 電子元件底部填充而設計。具有良好的填充速度，在不同的基材上表現出良好的韌性和附著力。

特徵:

- 熱板或烘箱速固化。
- 優秀的填充速度。
- 較長的使用時間。

硬化前特性		測試條件	測試方法
外觀	黑色		
黏度 @ 25°C	1000~2000 cps	Brookfield DV-III/CP-51 @ 5rpm	FT-P006
搖變系數 @ 25°C	1.0~2.0	Brookfield DV-III/CP-51 Visc. @ 0.5rpm/Visc. @ 5rpm	FT-P008
細度	<20µm	細度計	FT-P025
使用壽命 @ 25°C	>48 小時	黏度升高 25%@ 5rpm	FT-P024
保存期限 @0~ -10°C	6 個月		FT-P018
硬化條件		測試條件	測試方法
標準固化條件		130°C @ 10 分鐘(熱板)	
機械性質		測試條件	測試方法
晶片推力 @ 25°C	>10kg/die	晶片尺寸 80X80mil ,PCB 板材 熱板固化 130°C 10 分鐘	FT-M012

p.s.此表僅為 Feedpool 實驗室測試數據，投入生產前客戶仍需要針對產品做完整的驗證測試。

FeedBond® EP-30-UF1B

封裝絕緣膠

物理化學性質		測試條件	測試方法
硬度 Shore D	86	Shore D	FT-P037
熱裂解溫度	401℃	TGA 熱掃描	FT-P010
玻璃轉移溫度(Tg)	115 °C	DMA 3 點彎曲模式	FT-M014
熱膨脹係數			FT-M016
	< Tg 59 ppm/°C	TMA 膨脹模式	
	> Tg 148 ppm/°C		
儲存模數			FT-M019
	@25°C 2333 MPa	DMA 3 點彎曲模式試片厚度 <1.6 mm	
	@150°C 59 MPa		
	@250°C 72 MPa		

p.s.此表僅為 Feedpool 實驗室測試數據，投入生產前客戶仍需要針對產品做完整的驗證測試。

運用指導方針

運輸

運送過程皆放入乾冰或低溫冰袋等低溫保存並放置溫度指示劑以確保產品品質。當您收到貨品時發現已無乾冰殘留（或溫度指示劑呈現液態），請立即拍照存證勿使用並立刻通知我司營業人員。

解凍處理

解凍時，請將針筒（瓶、罐）直立解凍，直到完全達室溫時才能使用(一般包裝回溫時間60分鐘)，請擦乾解凍時凝結在包裝外的水氣；不可反覆解凍及冷凍以防止異常分離現象及氣泡等之產生。

儲存條件

當您收到貨品時，請立即以低溫（0~ -10°C）儲存。由於不同溫度下之保存將影響產品的壽命（保存溫度與產品壽命成正比）